附件1

**重点领域任务方向表**

| **序号** | **细分领域** | **任务方向（可补充）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芯片设计与制造 | 高端芯片及新结构、新原理集成电路先进制造工艺先进封测技术关键核心装备及零部件集成电路用高端材料……（可补充） |  |
| 2 | 通信与网络 | 6G通信技术与关键器件空天地海通信技术与网络光通信技术与网络关键核心装备及零部件……（可补充） |  |
| 3 | 软件与信息安全 | 操作系统信息安全区块链人工智能赋能技术专用软件……（可补充） |  |
| 4 | 新一代人工智能 | 智能算力硬件模型算法数据处理具身智能AI for Science人形机器人创新应用……（可补充） |  |
| 5 | 新型储能与新能源 | 氢能风能太阳能核能生物质能海洋能地热能新型储能储能装备及技术能源电子及智慧电网……（可补充） |  |
| 6 | 重点新材料 | 金属材料（特种钢铁材料、铜基材料、稀土材料、磁性材料、合金材料等）非金属材料（玻璃材料、陶瓷材料、半导体材料等）高分子材料（化工材料、聚酯材料、高性能纤维材料、弹性体材料、涂层材料等）复合材料（纤维增强复合材料，颗粒增强复合材料，层状复合材料，功能复合材料等）未来材料（仿生智能材料、纳米材料、超导材料等）材料共性技术（材料基因工程、生物制造技术、材料全生命周期设计与评价等）……（可补充） |  |